

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2025-037

有研半导体硅材料股份公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<有研半导体硅材料股份公司 2024 股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日在公司内部对本次拟激励

对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》，股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权，本次实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明

（一）调整原因

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本1,247,621,058股，扣除回购股份3,555,336股，以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元(含税)，占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-010)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生派发股票红利情况，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

（二）调整情况

根据公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派发股票红利情况，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1。根据以上公式，本次调整后的行权价格= $9.11-0.06=9.05$ 元/股。公司董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事会薪酬和考核委员会认为：本次调整符合《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 10 月 28 日